

上海硅产业集团股份有限公司

关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海硅产业集团股份有限公司子公司上海新昇半导体科技有限公司拟与太原市人民政府、太原中北高新技术产业开发区管理委员会签订《关于半导体硅片材料生产基地项目合作协议》，投资建设“300mm半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”。本项目计划总投资为人民币91亿元，最终投资总额以实际投资为准。
- 特别风险提示
 - 1、项目在实施过程中，可能受国际环境变化、宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将充分关注行业、市场和技术发展的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证项目健康可持续发展。
 - 2、本项目投资规模、建设周期、实施进度等均为计划数或预计数，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。
 - 3、本次签订的合作协议所涉及的项目用地需按照国家法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。
 - 4、本次投资资金来源为公司自有资金或各合作方募集资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情

形。本项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为积极响应国家半导体产业发展战略，充分发挥各自资源优势，打造半导体硅片材料生产基地项目，上海硅产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）子公司上海新昇半导体科技有限公司（以下简称“上海新昇”）拟与太原市人民政府、太原中北高新技术产业开发区管理委员会签订《关于半导体硅片材料生产基地项目合作协议》，投资建设“300mm 半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地”。本项目计划总投资为人民币 91 亿元，最终投资总额以实际投资为准。

（二）对外投资的决策和审批程序

公司于 2023 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于子公司拟签订半导体硅片材料生产基地项目合作协议的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（三）本次合作协议的签署不构成关联交易，不构成重大资产重组，不存在重大法律障碍。

二、合作协议签署主体

甲方：太原市人民政府

乙方：上海新昇半导体科技有限公司

丙方：太原中北高新技术产业开发区管理委员会

上海新昇半导体科技有限公司为公司全资子公司，其他签署主体与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、合作协议主要内容

（一）合作内容

1. 项目内容

以协议项下本项目落地先决条件均获满足为前提，乙方拟与甲方指定投资方（“太原投资方”）和其他投资方共同出资在太原中北高新技术产业开发区成立由乙方直接或间接控制的项目公司（“项目公司”），注册资金不低于人民币 50 亿元，并由项目公司建设 300mm 半导体硅片拉晶以及切磨抛生产基地（以下简称“本项目”）。本项目计划总投资为人民币 91 亿元，其中太原投资方拟出资人民币 20 亿元（最终投资总额以实际投资为准）。

2.意向选址

项目拟选址太原中北高新技术产业开发区上兰片区约 225 亩地块（“项目地块”），并预留邻近 100 亩左右土地供项目未来发展使用，土地使用年限为 50 年，具体地块（宗地编号为 SG-2307）位于太原市尖草坪区中北东街以南，柏板路以西，最终范围以依法公开出让的土地为准。

（二）甲方权利和义务

1.甲方负责组织相关投资方，以现金方式认缴人民币 20 亿元的出资额（最终出资额以实际出资为准）参与项目公司的投资设立，并承诺与项目公司其他投资方同步、同比例出资。

2.鉴于本项目是对山西省及太原市具有全局带动和重大引领作用的战略性新兴产业项目，且符合国家战略需要，国际市场需求大，甲方采用一事一议的方式进行支持，包括投资补助、供电保障、贷款奖补、研发奖励、项目配套、审批及规划建设保障、土地及厂房配套规划、人才政策配套等。

（三）乙方权利和义务

1.乙方负责本项目建设所需其余 71 亿元资金的募集（最终出资额以实际出资为准）。

2.以甲方、丙方根据本协议规定全面提供扶持政策为前提，项目公司须按协议约定的发展目标完成产值及其他目标。

3.项目公司有权享受山西省、太原市以及中北高新区各类现有以及后续出台扶持政策，涉及市、区两级政策体系同一方面甲方、丙方实际重复承担的，按照就高不重复原则兑现。

4.乙方项目应当严格按照项目规划持续投入资金进行建设，保证项目的建设进度。

5.在甲方和丙方协助顺利取得有关政府部门审批的前提下，太原中北高新投资发展有限公司和项目公司应保证本项目在项目开工建设之日起 14 个月内建设工程整体竣工，乙方应保证项目公司自竣工验收合格，且根据本协议约定的各项政府扶持政策出台并落实后的 9 个月内投产。

6.乙方不得改变该地块的用地性质及获批准的总体规划及规划条件，未经甲方或甲方指定部门同意，不得将该地块土地使用权的全部或部分转让给第三方（关联方除外）。

7.乙方将积极引进其产业链、供应链相关企业、项目，在甲方行政区域内尽快形成产业生态，同时乙方引进的相关企业、项目，经甲方审核通过后，可享受相应政策支持。

8.除各方另有约定以外，针对本项目中项目公司获得本协议约定的扶持、奖励、补助或补贴等资金，在经营期限未满 10 年的情况下，发生下列情形之一的，项目公司须全额退还按照本协议约定所获得的项目扶持或奖励资金。

（1）项目公司减少注册资本（股份制改制除外）、减少项目总投资至不符合协议约定的；

（2）未经甲方同意项目公司将土地、建筑物转让、出租改变经营项目的。

（四）丙方权利和义务

1.丙方在项目公司资料齐全并符合相关要求的情况下，为项目公司提供“承诺制+全代办”服务，服务内容包括从公司注册、项目立项、环评到竣工验收等手续的办理。

2.丙方在合法合规的前提下，优先为乙方及项目公司员工提供落户、优惠住房、员工宿舍、子女入学/教育、医疗等人才服务，并积极争取可享受的省、市、区相关人才政策（不受本协议条款限制）。人才政策以届时省、市、区普惠政策中最优惠的标准，按规定执行。

（五）生效和变更

本协议生效及项目落地的先决条件

1.本协议经甲、乙、丙三方法定代表人或授权代表签署并加盖单位公章或合同专用章；

2.项目公司已就本项目取得国家发改委窗口指导意见支持；

3.甲方以及丙方已出台符合本协议约定的关于本项目以及项目公司的扶持政策及优惠措施；

4.本项目落地事项经可行性研究报告确认可行，且经乙方内部决策及硅产业集团股东大会通过。

四、本次投资对公司的影响

本次合作协议的签署是根据公司业务发展和战略需求，基于公司在半导体硅片业务领域、特别是 300mm 半导体硅片业务领域研发和制造的经验做出的重大决策。通过本次投资，公司将加快 300mm 半导体硅片的产能建设和技术能力提升，为进一步提升公司市场份额、巩固国内领先地位扩大优势，并对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，符合公司的未来发展规划。

本次投资资金来源为公司自有资金或各合作方募集资金，不会对公司的正常生产及经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、本次投资的风险分析

1、项目在实施过程中，可能受国际环境变化、宏观政策变化、市场变化和技术进步等诸多因素的影响，项目可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将充分关注行业、市场和技术发展的变化，发挥整体优势，动态评估风险并同步调整风险应对策略，保证项目健康可持续发展。

2、本项目投资规模、建设周期、实施进度等均为计划数或预计数，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。公司将按照有关法律法规，及时履行相应的决策程序及信息披露义务。

3、本次签订的合作协议所涉及的项目用地需按照国家法律法规及政策规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交面积、价格及取得时间存在不确定性。

4、项目的后续进展情况如发生较大变化或取得阶段性进展，公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2023年12月30日